# Japanese Patent Laid-open Publication JP-A 62-065872

# METHOD AND DEVICE FOR REMOVING MATERIAL STUCK ON SURFACE OF FLEXIBLE SUPPORTING BODY

Laid open to public: 25 March 1987

Appl. No. 60-200664

Filed: 12 September 1985

Applicant(s): Fuji Photo Film Co., Ltd.

Inventor(s):
T. Sugiyama et al.

See the patent abstract attached hereto.

Partial translation

Page 4, lower right column, lines 5-9

Also, the solvent used in this process may be basically a type to form a layer of liquid stably on the support, and does not require performance of dissolving deposited material. However, it is naturally necessary to select a type of solvent not causing problems to the support surface in relation to quality.

# Page 5, from upper left column, line 11 to upper right column, line 2

For a coating process of a magnetic tape, the above-described deposit remover is disposed before coating of magnetic solution. The support was traveling at a traveling speed of 150 meters per minute and at a tension of 20 kg per 500 mm. One surface of the traveling support was coated by a roll coater 7 with xylol 8 in a uniform manner at 100 cc per  $\rm m^2$ , and thereafter, was passed through the component of the deposit remover. In sequence to this, solvent was completely eliminated in a solvent hot-air evaporator having a length of 5 meters. After this, a coater 9 shown in Fig. 4 was used to coat the support 1 above with magnetic solution 10 in a liquid state by the method disclosed in Japanese Patent Application No. 59-94657 with thicknesses of 7  $\mu m$ , 10  $\mu m$ , 20  $\mu m$  and 30  $\mu m$ .

Occurrence of missing of the coating at this time was checked.

Relation of claims 1 and 4 of the application to the document

The document discloses the removal of dust, the liquid for the dust removal, and the coating process. However, the document is silent on the sheet with the liquid crystal layer, and the rubbing process.

Relation of claims 10, 11 and 40 of the application to the document

The document is silent on the blow and suction of hot air.

Relation of claims 25, 26 and 41 of the application to the document

The document discloses the polishing process for the dust removal, and the liquid for the polishing process. However, the document is silent on the blow of air for the dust removal, and the rinsing process.

## METHOD AND DEVICE FOR REMOVING MATERIAL STUCK ON SURFACE OF FLEXIBLE SUPPORTING BODY

Patent Number:

JP62065872

Publication date:

1987-03-25

Inventor(s):

SUGIYAMA TAKESHI; others: 03

Applicant(s)::

**FUJI PHOTO FILM CO LTD** 

Requested Patent: | JP62065872

Application Number: JP19850200664 19850912

Priority Number(s):

IPC Classification:

B65H23/00; B65H5/00

EC Classification:

Equivalents:

#### Abstract

PURPOSE:To remove material stuck on the surface of a flexible supporting body without injuring the surface of the flexible supporting body by applying solvent on the flexible supporting body and pressing a blade on the surface of the supporting body before the solvent evaporates, together with the solvent. CONSTITUTION:A flexible supporting body 1 stuck with a material 2, is applied with a solvent film 3 on its surface, and passed between rollers 5 and 6. Here, a blade 4 is arranged between the rollers 5 and 6 along the direction of the width of a flexible supporting body 1 and perpendicular to the running direction. And by pressing the blade 4 against the flexible supporting body 1, stuck material 2 is scraped off the surface of the flexible supporting body 1 together with part of solvent film 3. Here, a blade surface 11 of the blade 4 which faces the flexible supporting body 1 is made to curve with radii of curvature of 2-30mm. The angles alpha at which the flexible supporting body enters the blade 4 are set to from 0.5-2 deg, and the angles beta at the side edge of the blade 4 where the flexible supporting body enters are set to below 90 deg..

Data supplied from the esp@cenet database - I2

## ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-65872

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和62年(1987)3月25日

B 65 H 23/00

6758-3F B-7539-3F

審査請求 未請求 発明の数 2 (全6頁)

②特 願 昭60-200664

②出 願 昭60(1985)9月12日

⑫発 明 者 杉 山 毅 小田原市扇町2丁目12番1号 富士写真フィルム株式会社

内

⑫発 明 者 柴 田 徳 夫 東京都港区西麻布2丁目26番30号 富士写真フィルム株式

会社内

**母発 明 者 武 田 日 出 男 小田原市扇町2丁目12番1号 富士写真フィルム株式会社** 

内

砂発 明 者 佐 藤 恒 彦 小田原市扇町2丁目12番1号 富士写真フィルム株式会社

南足柄市中沼210番地

内

⑪出 願 人 富士写真フィルム株式

会社

四代 理 人 弁理士 佐々木 清隆 外2名

明 細 替

1. 発明の名称

可挠性支持体の表面付着物除去方法及び装置

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 取り除きたい付溜物を製面に有する可視性支持体に溶剤を塗布した後、溶剤が蒸発してしまり前に該支持体面に下記の条件を満たす! 枚のプレードを押しつけることにより前記溶剤の一部と共に前記付潜物を除去することを特徴とする可説性支持体の製面付癥物除去方法
- 1) 骸プレードが骸支持体の進行方向とほぼ追 角に配置され、
- 2) 該プレードは該支持体の幅方向にはその幅 より長く、走行方向には短かい、支持体に対峙す る面を有し、
- 5) 該ブレードの該支持体と対峙する面はわん 助しており、その曲率rは2~30 mmである。
- 4) 該プレードは該支持体に対して、該支持体のプレードに進入する角度がプレード面の進入側ェッジ先端における接線に対し 0.5~2° の範囲

で深く支持体をラップさせる関係にあり、

- 5) 該プレードの支持体進入側端エッジの角度が90°以下である、及び
- 6) 該プレードが超硬質合金又は硬質体又はとの材料で少くとも表面部分を被覆した部材よりなり、該表面がR<sub>max</sub> で 0.5 μm 以下のあらさである。
- (2) 取り除きたい付着物を表面に有する可視性支持体の表面に溶剤を虚布する装置と、塗布された溶剤が蒸発してしまう前に該支持体面に押し付けられ、該付着物を前記溶剤の一部と共に除去する1枚のブレードとよりなり、該プレードが次の栄件を満たしていることを特徴とする可憐性支持体の表面付着物除去装置
- 1) 該プレードが該支持体の進行方向とほぼ直角に配置され、
- 2) 該プレード該支持体の幅方向にはその幅よ り長く、走行方向には短かい、支持体に対峙する 面を有し、
  - 3) 肢プレードの眩支持体と対峙する面は2~

5 0 mmの曲率 r でわん曲しており、

- 4) 該プレードは該支持体に対して、該支持体のプレードに進入する角度がプレード面の進入側エッジ先端における接線に対し 0.5~2° の範囲で深く支持体をラップさせる関係にあり、
- 5) 該プレードの支持体進入側端エッジの角度が90°以下であり、
- 6) 設プレードが超硬質合金又は健質体又はこの材料で少くとも表面部分を被覆した部材よりなり、該表面が R<sub>max</sub> で 0.5 μm 以下のあらさであ

#### 3. 発明の詳細な説明

#### [ 産業上の利用分野]

本発射は可視性支持体(以下「支持体」という) の表面付着物を除去する方法及び装置に関するも のである。

たお、本発明で言う「支持体」とは、一般に、 その幅が数cm乃至数m、長さが数10m以上、厚 さが数μm 乃至数100μm のポリエチレンテレ フタレート、ポリエチレン-26-ナフタレート、

ては、以下に掲げる方法がよく知られている。

[発明が解決しようとする問題点]

これらの方法においては、各々問題点を含んでいる。例えば、不敬布或いはブレードで捕捉する方法においては雕擦による支持体のスリ協発生、 静能気発生、及び不秘布による場合には不破布の 繊維自身の脱落による支持体表面への付着故障の セルロースダイアセテート、セルローストリアセテート、セルロースアセテートブロピオネート、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ボリカーポネート、ポリイミド、ポリアミド、等のブラステックフイルム:紙にポリエチレン、ボリブロピレン、エチレンブテン共重合体、等の炭素数が2~10のαーポリオレフイン類を強布又はラミネートした紙;アルミニウム、銅、錫、等の金属箔;等から成る可視性帯状物、あるいは酸帯状物を基材としてその表面に予備的な加工層を形成せしめてある帯状物が含まれる。

更に、前述した支持体は、その用途に応じた塗布液例えば写真感光性塗布液、磁性塗布液、装面保護、帯電防止あるいは滑性用塗布液、等がその要面に塗布され、乾燥した後、所望する幅及び長さに裁断されるものであり、その代表的な製品として各種写真フィルム、印画紙、磁気テーブ、磁気ディスク等が挙げられる。

#### 〔従来の技術〕

従来、支持体の表面付着物を除去する方法とし

発生がある。

高速空気吹き付け法は、数十ミクロン以上の比較的大きな付着物の捕捉には効果があるが、小さい付着物、或いは付着力の強い付着物については、ほとんど効果が認められない。又、上述の虚式除去法については、設備が非常に大きくなること及び高速で走行する帯状物の付着物除去に際しては、ミストの発生が激しく、このミストが周囲の設備のみならず、付着物除去後の支持体に付着してしまり結果を招いている。

また、支持体付着物の除去能力は、一般に鋭利 カブレードで掻きとる方法が最も大きいが、固定 の前記プレードのみでは該支持体にスリ傷を作り 易く、又静電気によりプレード先端に付着物が固 雅したり、粘着したりして実用的には付着物除去 能力として限界があつた。また、本出頭人は先に、 ブレードによる支持体付着物の除去の改良方法と して、支持体表面に溶剤を塗布した後に2つのブ レート(ブレード)によつて付着物を除去する方 法を提案した(特開昭59-150571号公報)。 この方法によると、前配の従来方法の欠点を解消 することができたが、支持体のプレードへの進入 方向が支持体進入側のプレードエッジの接線方向 であつたため付着物の一部がブレードの上端面に 入りこみ、付着物が除去しきれず一部支持体に残 ることもあつた。

従つて、本発明の目的は、上記方法をさらに改良し、可視性支持体表面の付滑物をより効果的に 徐去する方法及び装置を提供することにある。 〔問題点を解決するための手段〕

本発明者らは、先の溶剤強布とプレードの使用 による支持体の付別物除去方法についてさらに複 々の検討を取れた結果、以下にのべる本発明によ つて前記目的が達成できることを見出した。

すなわち、本発明は、取り除きたい付着物を表面に有する可染性支持体に俗別を途布した後、格別が蒸発してしまり前に該支持体面に下記の条件を消たす1枚のプレードを押しつけることにより前記裕別の一部と共に前記付着物を除去することを特徴とする可強性支持体の表面付着物除去方法

押し付けられ、該付贈物を前記容剤の一部と共に除去する 1 枚のブレードとよりなり、該ブレードが次の条件を満たしていることを特徴とする可挽性支持体の表面付贈物除去装置である。

- 1) 該プレードが該支持体の進行方向とほぼ 直角に配置され、
- 2) 該プレードは該支持体の幅方向にはその幅 より長く、走行方向には短かい、支持体に対峙す る面を有し、
- 3) 該プレードの該支持体と対峙する面は2~50 mの曲率 r でわん曲しており、
- 4) 該プレードは該支持体に対して、該支持体のプレードに進入する角度がプレード面の進入側エッジ先端における接線に対し 0.5~2° の範囲で深く支持体をラップさせる関係にあり、
- 5) 酸プレードの支持体進入燗端エッジの角度が90°以下であり、
- 6) 該プレードが超硬質合金又は便関体又はとの材料で少くとも装面部分を被機した部材よりなり、該表面が Rmax で 0.5 μm 以下のあらさであ

- 1) 酸プレードが該支持体の進行方向とほぼ値角に配置され、
- 2) 該プレードは該支持体の幅方向にはその幅より長く、走行方向には短かい、支持体に対峙する面を有し、
- 3) 酸プレードの酸支持体と対峙する面はわん曲しており、その曲率rは2~30mである。
- 4) 該プレードは該支持体に対して、該支持体のプレードに進入する角度がプレード面の進入側エッジ先端における接線に対し 0.5~2° の範囲で深く支持体をラップさせる関係にあり、
- 5) 該プレードの支持体進入側端エッジの角度が90°以下である、及び
- 6) 敗プレードが超硬質合金又は健選体又はこの材料で少くとも表面部分を被覆した部材よりなり、該表面がRmax で 0.5 μm 以下のあらさである。

又本発明は取り除きたい付滑物を製面に有する 可撓性支持体の製面に溶剤を逸布する装置と、 塗 布された溶剤が蒸発してしまり前に該支持体面に

**5** .

その結果、前記接級方向より深く a 5°~2° の範囲の角度で支持体をラップさせることにより 酸支持体を前記エッジ先端に接級方向で進入させ 得ることが判明した。また、それ以上の角度で支 持体をラップさせると、プレードの進入側で支持 体が直接プレードに接触し、すり傷を発生する原 因となることも明かになつた。また、本発明においてラップの範囲が 0.5°~2°の範囲であるのは、支持体の厚みによりその剛性が変化したり、ブレードの曲率により支持体のエッジ先端部の浮き上がり貴が変化するためであることもわかつた。

従つて、接線方向に対し Q 5°~2° 深い範囲 の角度で支持体をブレードエッジ先端部に進入させることにより付滑物を裕剤膜と共にかきおとし、 支持体に傷をつけることなく付着物の除去が可能 となつた。

又支持体に付着物が多いと思われる場合は、該付着物がブレード入射側エッジの同一位置に器積し、ブレードと支持体の間隙が局部的に増大することをなくすため、ブレードを支持体の幅方向に 
担助させる必要があり、本発明におけるブレード 
の支持体の幅方向の長さは、この知見においても 
支持体幅よりも適当に長いことが必要である。

また、ブレードは後記するように支持体と対峙 する面を有し、その面は2~30mの曲率 r でわ ん曲している。対峙面の曲率をとの範囲に進んだ

のは支持体の厚みにより削性が異なるので、支持体の厚みにより削性が異なるのでしませる必要があるからである。例えば、支持体の厚みが5 μm 近傍の場合はプレードの曲率は2~5 mm が好ましく同支持体の厚みが100μ近傍の場合はプレードの曲率が好ましい。本発明におけるブレードの支持体進入側端のエッシの角度は90°より大であると支持体がブレード上に進入しやすいためである。

また、前記プレードはWC-TACの如き超硬合金またはファイダセラミックス、アルミナA-150、ジルコニア等の硬質体か、少くとも装面部分をこれらの材料で被優した部材よりなり、その表面はRmax で Q5 μm 以下のあらさ、すなわち、高度の平滑性を有している。

以下図に従つて本発明の辞細を説明する。

第1図は本発明の一例を示す斜視図(密削塗布部は省略)である。第1図において付瘡物(2)を有

しては数ミクロンオーダーの付着物 1 が除去可能 になつた。

又、ブレード4の支持体1の進入側端エッジの 角度 β は 9 0 ° 以下である。

又、この工程に使用する格剤とは基本的には支持体上に安定に液膜を形成するものであればよく、付着物を溶解する能力は必要ない。但し、支持体 要面に品質上の支障をきたさない溶剤を選ぶのは 当然必要である。溶剤としては、キシロール、節酸プテル等が用いられる。 掻落し溶剤を循環使用するかしないか或いは上述工程の後で加熱蒸発を行なりか行なわないかは、適宜決めればよい。

以上の方法により従来技術のもつ欠点を取り除 く事が出来、支持体表面に品質上の問題を生ずる 事なく効果的な付着物除去を行なうことが出来る。 〔実施例〕

以下に本発明を磁気テープの支持体に適用した 実施例にて更に具体的に説明する。その実施想様 の略図は第3図に示す。プレード部の略図は第2 図と同じである。プレード4のプレード面11曲 率 r は 1 2 mm であり支持体入射側エッジ角度は 7 0° である。プレード 4 の接線方向は水平に対しま0° であり支持体の進入角は水平に対し 1 9° (α=1°)である。ロール 5 と 6 の間隔は 400 mm でありプレードはその中間にある。

他の条件は以下の通りである。

支持体:材質ポリエチレンテレフタレート

厚味 3 B #

rp 500 mms

密 剤:キシロール

磁気テープの塗布工程において、磁性液を塗布する前に上述の付着物除去装置を設け、走行速度150m/分、テンション20kg/500mで走行している前記支持体の片面にロールコータープにてキシロール8を100℃/m²で一根に塗布したで、上記の付着物除去装置部を通過させ、引き税いて長さ5mの溶剤熱風蒸発部で溶剤を完全に除去した。その後、第4図に示す様を塗布装置りを用い特願昭5つ9・94657号公報に記載の方法にて磁性液10を液状で上記支持体1に7μm、

混合分散させて磁性盗布液とした。

期 1 段

7- P 02 0g 初末(長径方向の平均 初径 0.5 μの針状粒子、抗磁力 5 2 0 エルステッド	300直接地
塩化ビニル - 酢酸ビニル共直合体 (共加台比 87:13 、塩合皮 400)	通量取りを
郷毘住カーボン	20 <u>地</u> 量部
ポリアミド樹脂(アミン価300)	15 班拉斯
レシチン	6 互业部
シリコンオイル (ジメチルボリシロキサン)	3 近東市
キシロール	an o mail
メチルイソブチルケトン	30 U <u>De We</u> nd
n - ブタノール	100班班部

こうして神られた磁性並布液の平衡粘度を結准 数作所製の島維レオメータ RM-1 により側定した ところ剪断選度が 1 0 sec-1 においては 8 poise、 10 μm、20 μm、30 μm の厚さにそれぞれ強布し、その時の強布ぬけの発生状況を調べたた。これでいう強布ぬけとはピンホール状及びすじたの完全な強布ぬけの他、規定厚味の50 を以下では必然の事業を持つ海盗り部分も含んでいる。すじたの強衛を持つ海盗ののでのよっては約100 m連続して発生したの時点で磁性層強布のみ一旦中止した再強り付けを行ない良好な状態の戻した後、調査を続行した。又強布ぬけ部分の検出は巻取る前に欠陥検出器を用いて連続的に行ない、発生頻度をピンホールとすじ状のものに分けて把握した。

比較として支持体の付着物除去を行なわずに磁性層を上記と同一条件で塗布したものと特開船59-150571に示した付着物除去装置をもちいたものについて、その発生頻度を調査した。尚、上記の実験に使用した磁性塗布液は以下のものである。

第1表に示す組成の各成分をボールミルに入れて十分に混合分散させたのち、エボキン樹脂(エボキン当益500)を50重量部を加えて均一に

又 5 0 0 sec-1 においては 1 poise を示した。

各水準共、長さ4000mの原反ベース10本 についてデータを採つた。その結果を第2表に示 す。第2段の数値は原反ベース1本当りの平均発 生度数を表わしている。

第 2 表

テスト采件		結 呆		
試料Na	除塵装置	磁性層 液状愈布厚	ナじ	ピンホール
1	本発明装置	7	0.5	<u>L</u> 7
2	特開昭 59- 150571装置	,,	1.0	1.5
5	なし		5.0	40.2
4	本発明装置	10	O.	0.2
5	特開昭 59- 150571 装置	"	O.	0.6
6	なじ	,	4.8	3 5.3
7	本発明装置	2 0	0	0
8	特開昭 59- 150571 装置	"	۵	0
9	なし	"	1.9	1 4.6
10	本発明装置	3 0	0	a
11	特開出 59- 150571 装置	"	٥	G
1 2	なし	п	0.4	2.2

#### [発明の効果]

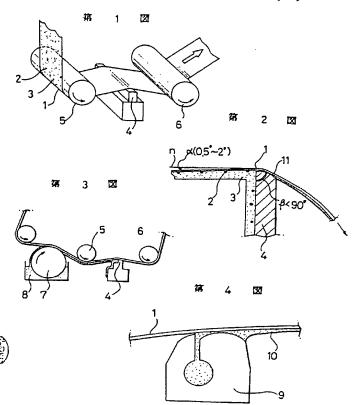
本発明によるときは、支持体にスリ協等を生ずることなく、小さな付着物までほぼ完全に除去することができる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一例を示す斜視図(溶剤塗布部は省略)第2図は本発明におけるブレード部の概略断面図、第3図は本発明の一実施態様を示す説明図、第4図は実施例で支持体の表面性の評価に用いた磁性層塗布装置である。

1 …支持体、2 …支持体の付着物、3 … 密刺層、4 … ブレード、5 …上流側迂回ローラー、6 …下流側迂回ローラー、8 … キシロール、9 … 塗布装置、10 … 磁性塗布液

代理人 弁理士(8107) 佐々木 消・隆 (ほか2名)



### 手続補正書

昭和 60年 11月 5月

特許庁長官殿

1792)

1. 事件の表示

昭和 60 年特許願第 200664 号

- 2. 発明の名称
  - 可視性支持体の表面付着物除去方法及び装置
- 3. 겖正をする者

事件との関係:特許出願人

名 称 (520) 富士写真フイルム株式会社

- 4. 代 理 人
  - 作 所 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 (後が関ビル29時 霞が関ビル四頭側開 私ご前衛49号

**栄光特許事務所 電新(581)—9601(代表)** 

氏名 #理士 (8107) 佐々木 稍 隆 (12か2 名)

5. 補正命令の日付 自 発

1) 明細帯の発明の詳細な説明の欄を下記の通り 補正する。

第5頁11行目の「まく船」を「はく離」と 補正する。

第15頁1行目の「エッジ角度」の後に「β」を加入する。

第15頁3行目の「±0°」を「+20°」と補正する。

○ 第 1 5 頁 1 3 行目の「2 0 Kg/ 5 0 0 mm」を「2 0 Ky/ 5 0 0 mm 巾」と補正する。

- 一般和一年 月 日(答答日:昭和 年 日 日)
- 6. 補正により増加する発明の数 0
- 7. 補正の対象

明細醇の「発明の詳細な説明」の欄

8. 補正の内容

